

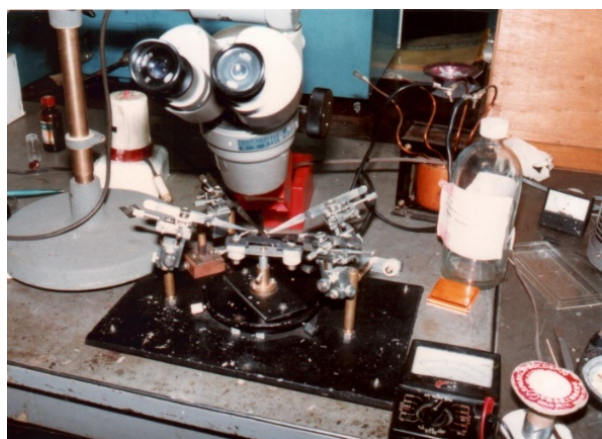
6 組立(ダイシング、ワイヤボンディング)とテスト



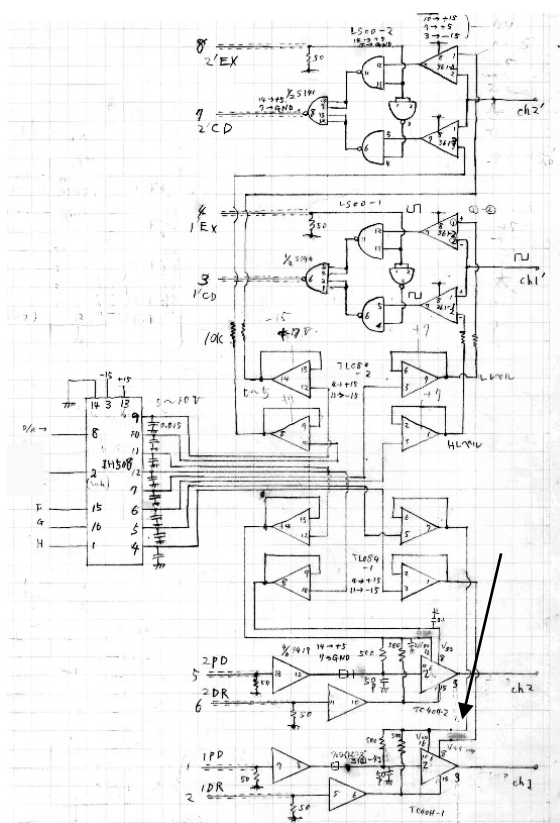
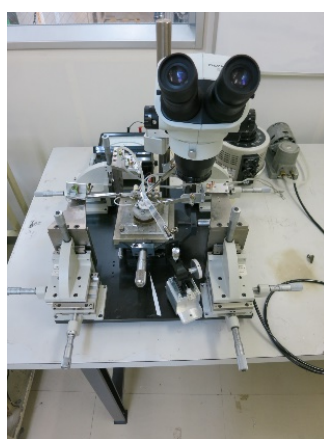
ダイシング装置 (ウェハからチップ分割)



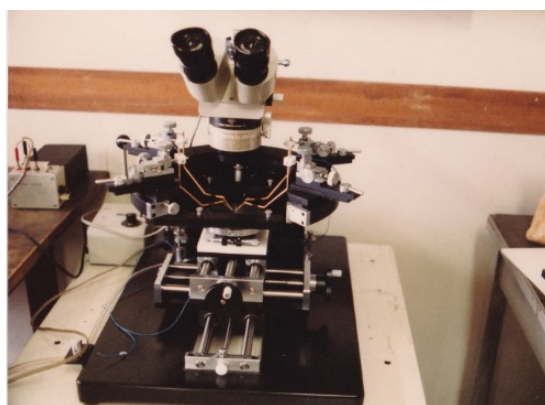
超音波ワイヤボンダ (展示)



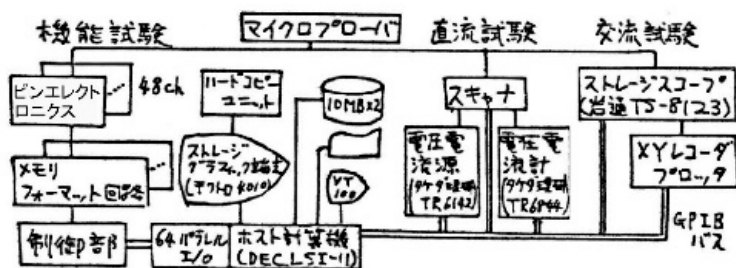
クリーム半田を用いた微小はんだ付け装置(右は展示品)



LSI テスト用ピンエレクトロニクス
(端子接続部)(2ch 分)



テスト用マイクロプローバ



テストシステム